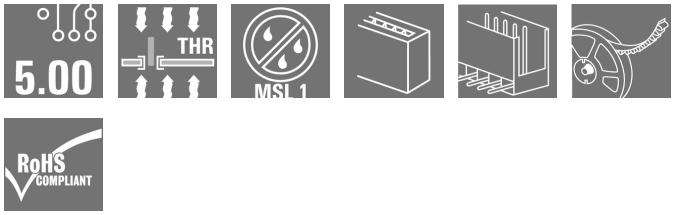
OMNIMATE Kryt - řada CH20M
SHL-SMT 5.00/02GL 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com





Systém CH20M přirozeně rovněž prokazuje svou dokonalost v rozhraní s periferiemi.
Pokud zvážíte možnosti návrhu, zpracování, použitelnosti, spolehlivosti a bezpečnosti, pak jsou hlavy kolíků a konektory v reálném světě stejně kriticky důležité jako celý systém.
V každém sektoru je technologie spojování ve své třídě na vrcholu.

- **100% nezaměnitelnost** Jedinečné, pevně přichycené samonastavitelné kódování zajišťují nezaměnitelné označení spojů.
- **100% bezpečné** Na obou stranách ochrana proti dotyku kolíků i bloku zásuvek
- **100% účinné** Všechny hlavy kolíků THR jsou kompatibilní s technologií pájení přetavováním

Všeobecné objednací údaje

Typ	SHL-SMT 5.00/02GL 1.5RL
Objednací číslo	1069650000
Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, Připojovací prvek, levý, řada kolíků, otevřená strana, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, Černá, Tape
GTIN (EAN)	4032248825103
Mnž.	260 ks
Údaje výrobku	IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
Balení	Tape

OMNIMATE Kryt - řada CH20M
SHL-SMT 5.00/02GL 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	22 mm	Délka (v palcích)	0,866 inch
Šířka	10,4 mm	Šířka (v palcích)	0,409 inch
Výška	14,4 mm	Výška (v palcích)	0,567 inch
Čistá hmotnost	1,885 g		

Parametry systému

Skupina produktů	OMNIMATE Kryt - řada CH20M	Typ připojení	Připojení desky
Montáž na PCB desku	Připojení pájením přetavením průchozím otvorem	Rozteč v mm (P)	5 mm
Rozteč v palcích (P)	0,197 inch	Výstupní tvarovka	90°
Počet pólů	2	Počet pájených kolíků na pól	1
Pájecí kolík, délka (l)	1,5 mm	Tolerance délky pájecích pinů	+0,1 / -0,3 mm
Tolerance rozmístění pájecích pinů	± 0,1 mm	L1 v mm	5 mm
L1 v palcích	0,197 inch	Počet řad	1
Množství řady kolíků	1	Může být kódováno	Ano
Cykly zapojování	25		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP	Barevný	Černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Skupina izolačního materiálu	IIIa
CTI	≥ 175	Izolační síla	≥ 10^8 Ω
Moisture Level (MSL)	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	pocínované
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota, max.	120 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-30 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	120 °C		

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984	Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	10 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)	9 A	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	320 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	4 kV	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	4 kV		

OMNIMATE Kryt - řada CH20M
SHL-SMT 5.00/02GL 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA)		Č. osvědčení (CSA)	200039-70153051
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)	50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)	300 V	Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)	9 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)	9 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)	9 A
Průřez vodiče AWG, min.	AWG 26	Průřez vodiče AWG, max.	AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (cURus)		Č. osvědčení (cURus)	E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)	50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)	300 V	Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)	9 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)	9 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)	9 A
Průřez vodiče, AWG, min.	AWG 26	Průřez vodiče, AWG, max.	AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02	eClass 8.1	27-44-04-02
eClass 9,1	27-44-04-02	eClass 9.0	27-44-04-02

Poznámky

Poznámky	
IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

OMNIMATE Kryt - řada CH20M
SHL-SMT 5.00/02GL 1.5RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

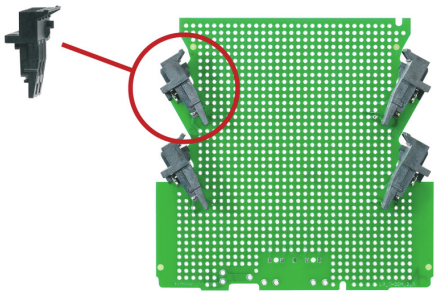
Brožura/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	CSA Certificate of Compliance
Technické údaje	STEP

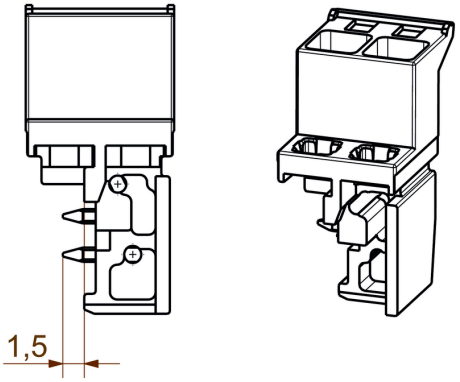
OMNIMATE Kryt - řada CH20M
SHL-SMT 5.00/02GL 1.5RL

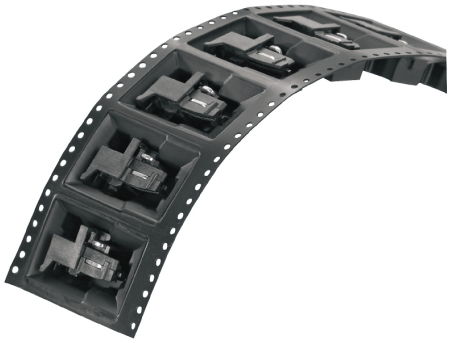
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

for left side







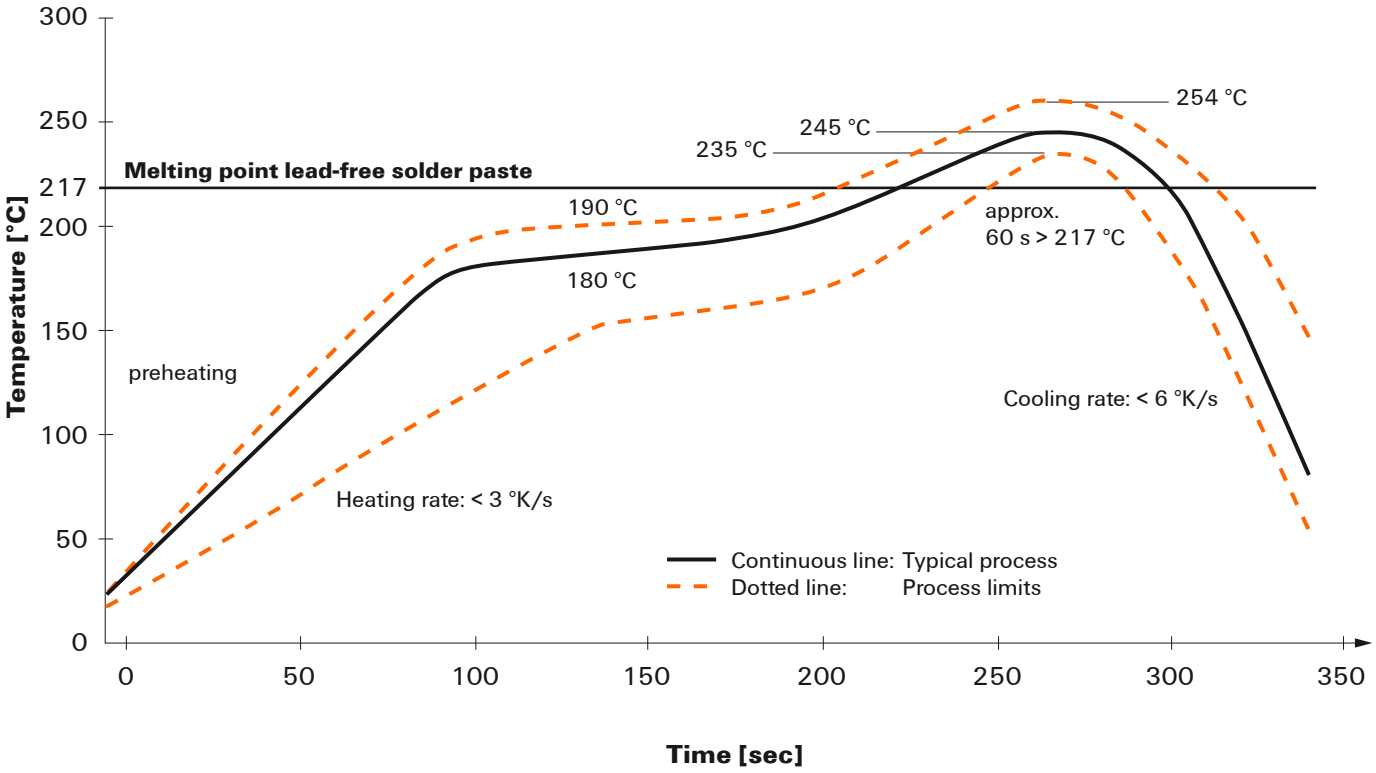
delivery



Reflow Solder Profile

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically ≤ +3K/s. In parallel the solder paste is ‚activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at ≥ -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

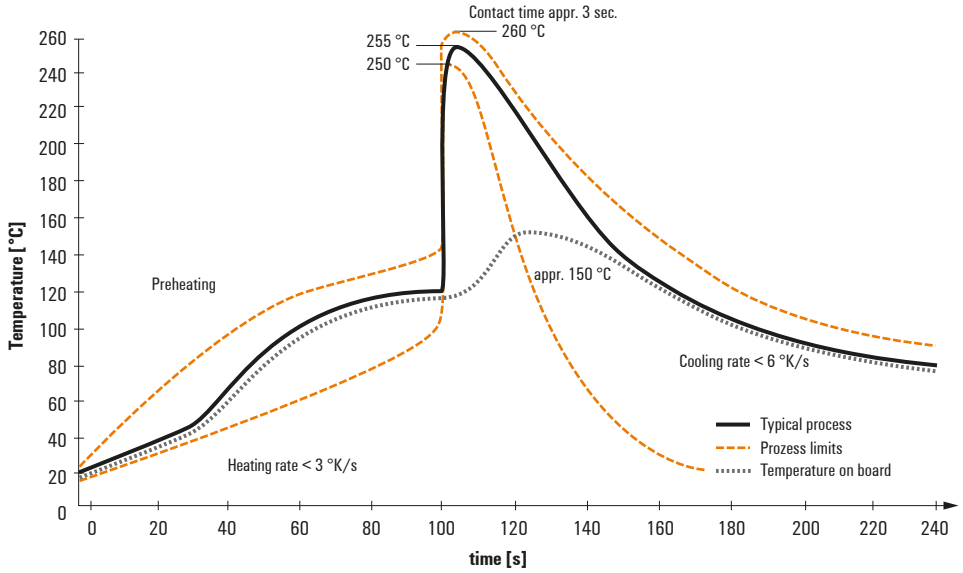
We reserve the right to make technical changes.

Wave Solder Profile

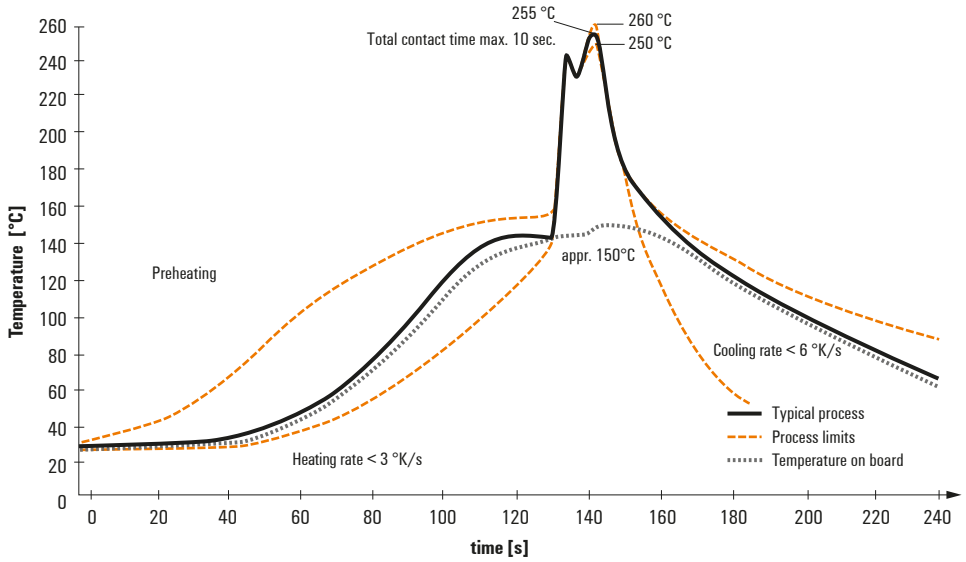
Recommended wave solderding profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

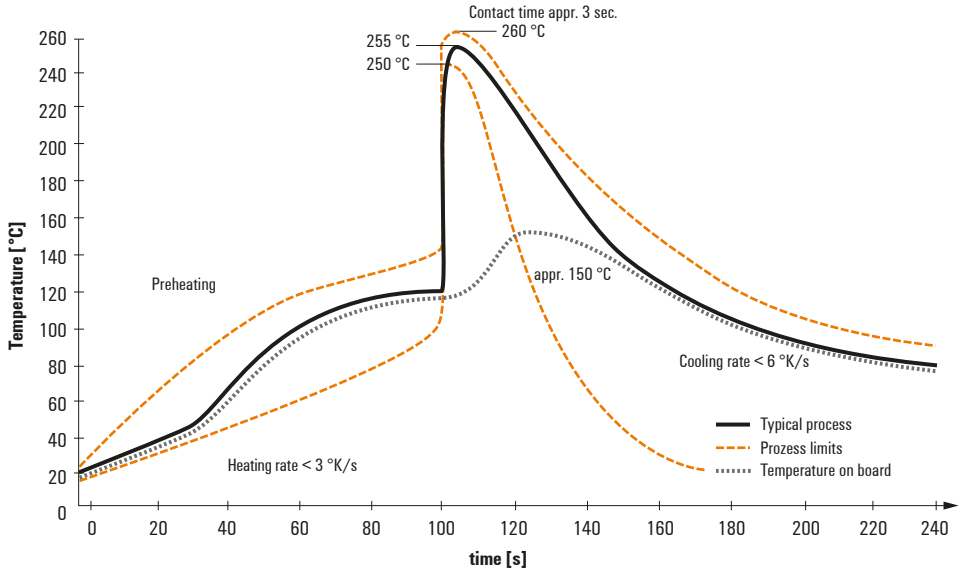
We reserve the right to make technical changes.

Wave Solder Profile

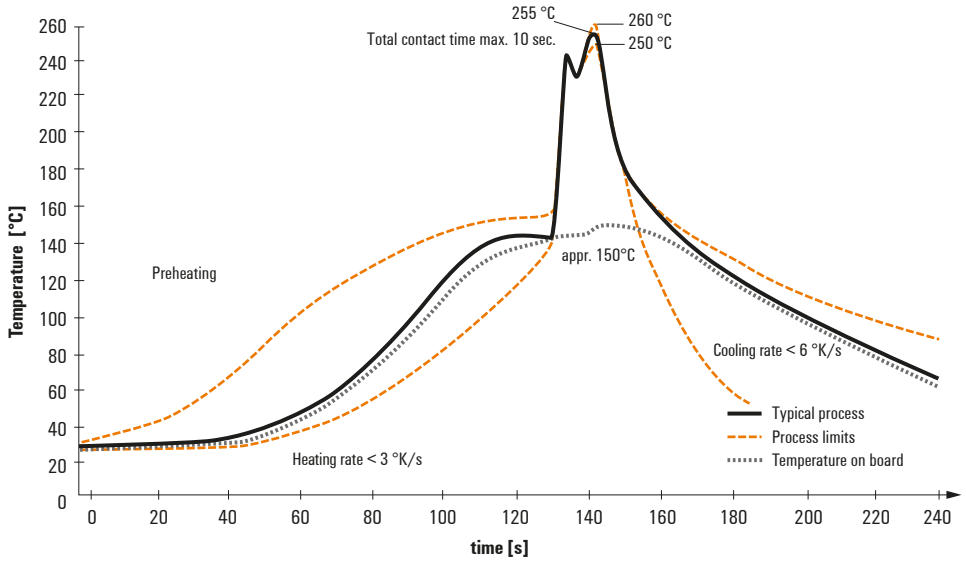
Recommended wave solderding profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

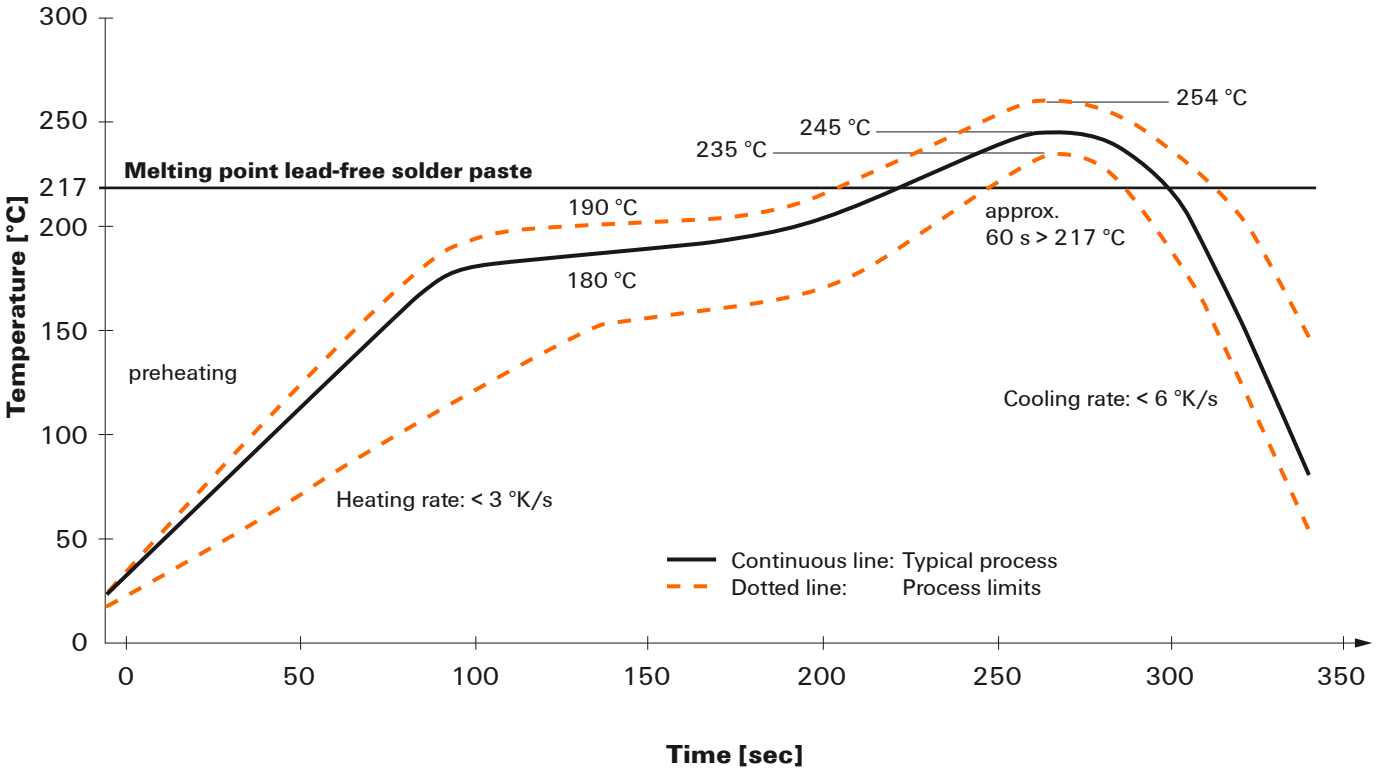
The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Reflow Solder Profile

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically ≤ +3K/s. In parallel the solder paste is ‚activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at ≥ -6K/s solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.